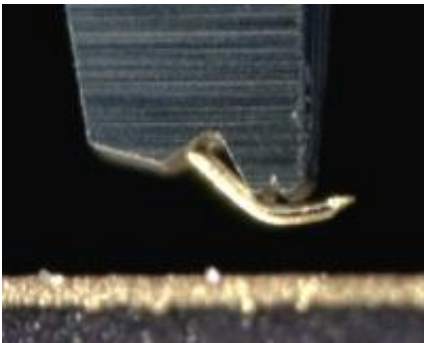


TPT-Applikation Standard 25 μ Gold Wedge-Wedge bonden

Material:

- 25 μ Gold Draht, 100m auf 2"-Spule
- Standard Gold Wedge (Keil / Sonotrode)
- Halbautomatischer Wedge-Wedge Drahtbonder HB16



Gold Wedge



Wedge-Bond auf Mikrochip



Wedge-Bond

Bondprozess:

- Der Draht wird durch den Wedge von hinten nach vorne gefädelt.
- Die Bondparameter sowie die Bond-Länge und Höhe werden eingestellt.
- Nach dem zweiten Bond schließt die Klammer und der Draht wird abgerissen.
- Es wird empfohlen für stabilere Bonds die Heizung des Substrats auf 120°C einzustellen.

Vorteile gegenüber Ball-Wedge Bonden:

- Der Wedge Keil braucht weniger Fläche, ein kleinere Pitch ist möglich.
- Flachere, längere und stabilere Loops möglich.
- Aluminium Draht kann verarbeitet werden.
- Aluminium Draht wird unter Raumtemperatur verarbeitet, ein Heizen ist nicht nötig.

